

2023-2029年中国半导体封 测市场深度分析与投资前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国半导体封测市场深度分析与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202308/394539.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

半导体行业主要包含电路设计、晶圆制造和封装测试三个部分。封装测试是半导体产业链的最后一个环节。半导体封装测试是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。2018年中国半导体封测市场规模2194亿元，较2017年同比增长16.1%，2019上半年封测销售额为1022亿元。2004年至今，我国半导体封测行业一直保持高速发展，年复合增长率为15.8%。封测行业高速发展的同时，半导体市场占比逐年下降，2018年占整个中国半导体市场的34%，这说明了封测作为我国半导体产业的先行推动力，已经起到了带头作用，推动半导体其他环节快速发展。半导体封测业务公司主要集中在中国大陆和台湾，台湾日月光收购硅品后市占率高达37%，大陆企业长电、华天和通富总占比约25%。2019年Q2封测业受到中美贸易摩擦、手机销量下滑及存储器价格偏低等因素拖累，大多数封测厂商营收持续走跌，京元电和欣邦科技营收增长受益于面板市场超预期增长。近年来，海外并购使中国企业迅速崛起，获得了技术、市场，弥补一些结构性缺陷。但很明显，封装检测行业具有明显的马太效应，海外优质并购的目标大大降低，通过并购获得先进封装技术和市场占有率的可能性很小，自主研发技术升级将成为主流。我国试验业未来的发展方向应从“增长量”向“质突破”转变。中企顾问网发布的《2023-2029年中国半导体封测市场深度分析与投资前景报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：第一章 我国半导体封测概述 第一节 行业定义 第二节 行业特点和用途 第二章 国外半导体封测市场发展概况 第一节 全球半导体封测市场分析 第二节 亚洲地区主要国家市场概况 第三节 欧洲地区主要国家市场概况 第四节 美洲地区主要国家市场概况 第三章 2022年我国半导体封测环境分析 第一节 我国经济发展环境分析 第二节 行业相关政策、标准 第四章 我国半导体封测技术发展分析 第一节 当前我国半导体封测技术发展现状分析 第二节 我国半导体封测技术成熟度分析 第三节 中、外半导体封测技术差距及其主要因素分析 第四节 未来提高我国半导体封测技术的策略 第五章 半导体封测市场特性分析 第一节 半导体封测市场集中度分析及预测 第二节 半导体封测SWOT分析及预测 一、优势半导体封测 二、劣势半导体封测 三、机会半导体封测 四、风险半导体封测 第三节 半导体封测进入退出状况分析及预测 第六章 我国半导体封测发展现状 第一节 我国半导体封测市场现状分析及预测 第二节 我国半导体封测产量分析 第三节 我国半导体封测市场需求分析 一、2019-2022年我国半导体封测需求量 二、主要应用领域情况 第四节 我国半导体封测价格趋势分析 一、2019-2022年半导体封测价格分析 二、影响半导体封测价格的因素 三、未来几年半导体封测市场价格预测

第七章 2018-2022年我国半导体封测行业经济运行 第一节 2018-2022年行业偿债能力分析 第二节 2018-2022年行业盈利能力分析 第三节 2018-2022年行业发展能力分析 第四节 2018-2022年行业企业数量及变化趋势 第八章 2017-2022年我国半导体封测进、出口分析 第一节 2022年半导体封测进、出口特点 第二节 2017-2022年半导体封测进口分析 第三节 2017-2022年半导体封测出口分析 第四节 2023-2029年半导体封测进、出口预测 第九章 2019-2022年主要半导体封测企业及竞争格局（企业可自选） 第一节 日月光控股 一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年半导体封测产品研究 四、发展战略 第二节 江苏长电科技股份 一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年半导体封测产品研究 四、发展战略 第三节 通富微电子股份 一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年半导体封测产品研究 四、发展战略 第四节 天水华天科技股份 一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年半导体封测产品研究 四、发展战略 第五节 苏州晶方半导体科技股份 一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年半导体封测产品研究 四、发展战略 第六节 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年半导体封测产品研究 四、发展战略 第十章 2023-2029年半导体封测投资建议 第一节 半导体封测投资环境分析 第二节 半导体封测投资进入壁垒分析 一、经济规模、必要资本量 二、准入政策、法规 三、技术壁垒 第三节 半导体封测投资建议 第十一章 2023-2029年我国半导体封测未来发展预测及投资前景分析 第一节 未来半导体封测行业发展趋势分析 一、未来半导体封测行业发展分析 二、未来半导体封测行业技术开发方向 第二节 半导体封测行业相关趋势预测 一、政策变化趋势预测 二、供求趋势预测 三、进、出口趋势预测 第十二章 2023-2029年业内对我国半导体封测投资的建议及观点 第一节 投资机遇半导体封测 第二节 投资风险半导体封测 一、政策风险 二、宏观经济波动风险 三、技术风险 四、其他风险 第三节 行业应对策略

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202308/394539.html>